

Automaty Pick&Place

Zobacz w działaniu - DEMO ROOM w siedzibie Renex



Seria MX - 310/240/110

- Wydajność : od 14 000 do 36 000 komponentów na godzinę
- Od 6 do 16 szybko pozycjonujących głowic
- Wysoka precyzja, rozdzielczość 0,025 mm
- Maksymalne wymiary PCB: 660x460 mm
- Maksymalny rozmiar komponentu: 50x50 mm
- Układanie komponentów jednocześnie na dwóch PCB
- Zaawansowany system wizyjny - rozpoznawanie i weryfikacja komponentów
- Precyzyjne naprawy liniowe
- Inteligentne podajniki komponentów
- Intuicyjne oprogramowanie sterujące (system Windows™)
- Bogate wyposażenie opcjonalne

Atrakcyjna cena
od 96.000 EURO

Rentgeny i urządzenia do prac z dużymi BGA



Rentgeny inspekcyjne

- Duży wybór urządzeń konfigurowanych do indywidualnych potrzeb
- Pełna weryfikacja efektów procesu lutowicznego
- Wewnętrzny obraz po czyszczeniu lutowicznego
- Bardzo wysoka rozdzielczość
- Napięcie anodowe do 130 kV
- Programowalny ruch płytki
- Oprogramowanie w systemie Windows™

Systemy naprawcze Summit

- Automatyczne systemy naprawcze do BGA, CSP i QFP (od najmniejszych po bardzo duże komponenty)
- Opcja bezkontaktowego usuwania lutowni
- Najwyższa jakoć optyka
- Cyfrowe przetwarzanie obrazu
- Automatyczny podajnik komponentu i antywstrząsowa podpora płytki
- Dokładne pozycjonowanie 12,5 µm.
- Unikalna funkcja automatycznego tworzenia profilu termicznego
- Oprogramowanie w systemie Windows™



NAJLEPSZE PODSTAWY ROZWOJU



e-mail: office@renex.com.pl
www.renex.com.pl

87-800 Włocławek
Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
tel./fax (054) 231-10-05, 411-25-55